

MECHANISCHE MIKROBEARBEITUNG

14 SPECIAL: Mit innovativen Werkzeug-, Spann- und Maschinenkonzepten werden letzte Lücken in der Prozesskette geschlossen

0114

www.mikroproduktion.com

Mikroproduktion

Im Optimum

41 UKP-Laser mit flexiblen Pulszügen bieten Top-Leistung

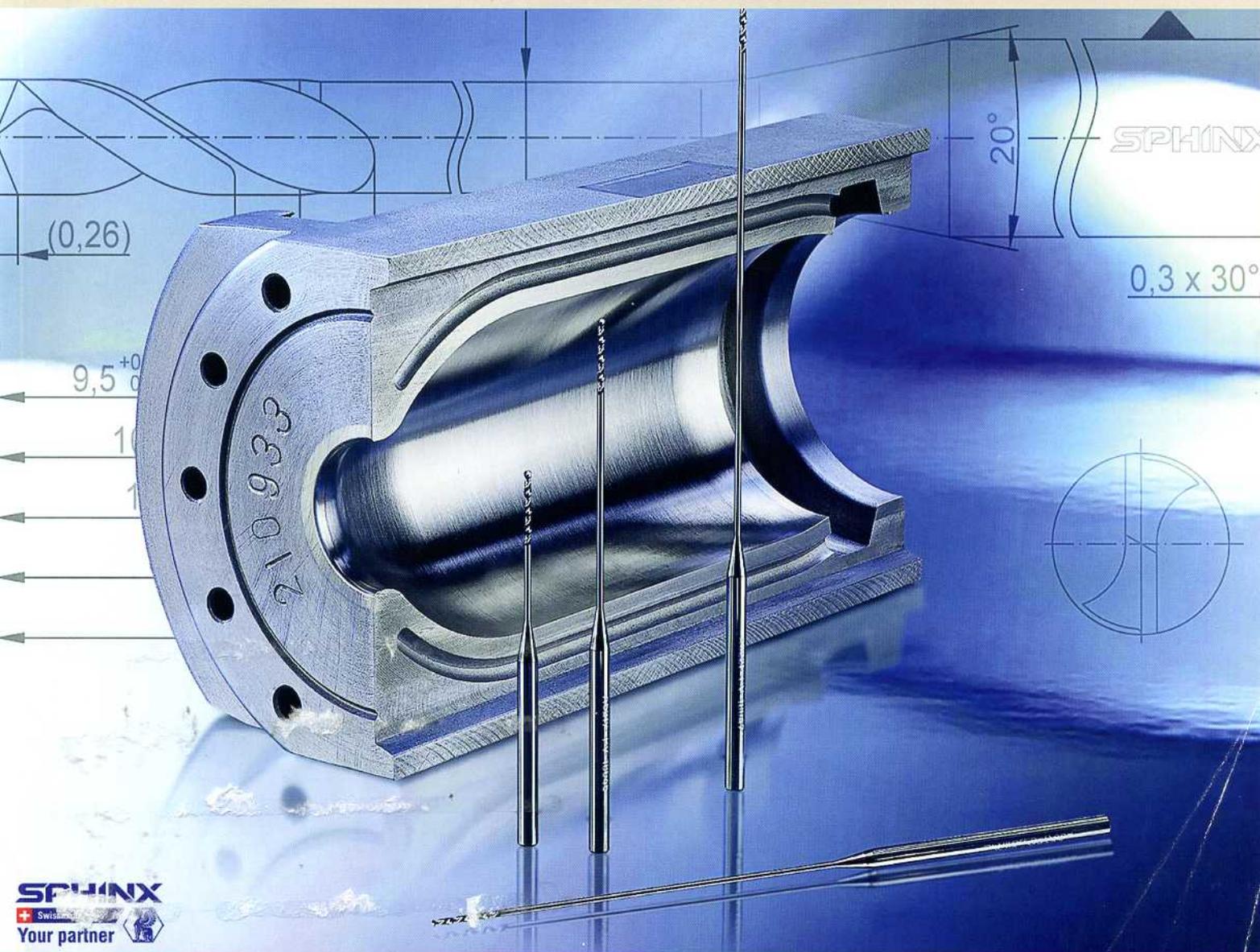
Im Blickfeld

50 Zerstörungsfreie Bauteilanalyse mit Röntgen-Tomografie



Im Wachstum

38 Lasersintern mit bislang unerreichter Strukturauflösung



SPHINX
+ Swiss
Your partner

> KURZ GEMELDET

+++ Ein neuer Name unterstreicht das Profil der Georg Fischer AG

Am 1. Januar 2014 wurde GF AgieCharmilles in GF Machining Solutions umbenannt, was die Georg Fischer AG (GF) als ein einheitliches Unternehmen mit drei Divisionen hervorhebt. GF AgieCharmilles bietet seinen Kunden weltweit eine große Angebotspalette an Fräs-, EDM-, Laser-, Spindel-, Tooling- und Automatisierungssystemen. Der neue Name betont die Positionierung der Division als Lösungsanbieter und global kundenorientierter Partner. Neben der Namensänderung findet die schrittweise Einführung eines neuen Designs auf der Website sowie bei den Verkaufsmaterialien von GF Machining Solutions statt. Da die Marken AgieCharmilles, Mikron, Step-Tec und System 3R von hohem Wert sind, wird die Division diese vorerst weiterverwenden. Die aktuellen E-Mail-Adressen behalten bis Dezember 2014 ihre Gültigkeit. Die Telefonnummern bleiben unverändert. Ab Januar 2014 wird die bestehende Website www.gf.com automatisch zur neuen URL umgeleitet.

www.gf.com

> PERSONEN

Neuer Vorstand beim VDE/VDI

Die VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM) hat seit Anfang des Jahres einen neuen Vorstand. Neuer Vorsitzender ist Prof. Dr. Christoph Kutter, Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für Modulare Festkörper-Technologien (EMFT),



Christoph Kutter

Stellvertreter sind Dr. Udo-Martin Gómez, Chief Technical Officer der Bosch Sensortec GmbH, und Prof. Dr. Wilfried Mokwa, Leiter des Lehrstuhls 1 des Instituts für Werkstoffe und Elektrotechnik an der RWTH Aachen.

Die VDE/VDI-Gesellschaft hat die Aufgabe, die wissenschaftliche und technische Entwicklung im Bereich der Mikroelektronik, Mikrosystem-, Nano- und Feinwerktechnik sowie deren breite Anwendung zu fördern. Sie initiiert den dazu erforderlichen Dialog zwischen Herstellern, Anwendern und Wissenschaft und bildet ein Forum für Diskussionen über diese Techniken in der Öffentlichkeit.

www.vde.com/gmm

3D-Revolution jetzt mit 3D fab+print

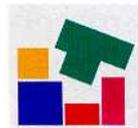
Messe Düsseldorf und VDMA initiieren die Marke 3D fab+print. Auf leisen Sohlen hat sich eine Revolution in der Fertigungstechnik vollzogen, ohne dass Big Player eine wesentliche Rolle dabei gespielt hätten. Dabei ist der Einsatz des 3D-Drucks gar nicht so neu. Schon lange wurden laserbasierte Verfahren für Industrieanwendungen entwickelt, etwa für die Herstellung von Prototypen und Modellen oder beispielsweise für die Produktion von Werkstücken und Bauteilen in geringen Stückzahlen. Gegenüber dem sonst für diese Prozesse eingesetzten Spritzgussverfahren entfällt bei der Herstellung mithilfe des 3D-



Drucks das aufwendige Herstellen von Formen sowie die Arbeitsschritte Schneiden, Drehen und Bohren. In Zeiten, in denen die Produktlebenszyklen kontinuierlich sinken, während die Variantenvielfalt stetig zunimmt, kommen unermüdliche Druck-Roboter, die mit höchster, von Menschenhand unerreichbarer Qualität komplexe Gegenstände hochindividuell herstellen können, wie gerufen: vor allem für die Werkzeugtechnik, Bauteilproduktion, Medizintechnik und Konsumgüterindustrie. Aus diesem Grund haben die Messe Düsseldorf und der VDMA anlässlich der K 2013 im Oktober 2013 die Marke 3D fab+print gelauncht. Unter diesem Dach werden künftig auf den relevanten Düsseldorfer Fachmessen die entsprechenden Aussteller zusammengeführt und das gesamte Thema in den Fokus der Fachöffentlichkeit gerückt. Themenrelevante Messen mit 3D fab+print sind die Comamed (12.–14.11.2014), das Messe-Quartett Gifa, Metec, Thermprocess und Newcast (16.–20.06.2015) sowie die drupa (31.05.–10.06.2016).

www.drupa.de

smartsystems integration



Smart Systems Integration 2014 in Wien

Kongressprogramm veröffentlicht. 60 Vorträge, 46 Poster-Präsentationen und fünf Keynotes werden den Teilnehmern auf der Smart Systems Integration 2014 vom 26. bis 27. März 2014 in Wien geboten. Hochkarätige Referenten aus Wissenschaft und Industrie präsentieren internationalen Experten Innovationen, Anwendungen und Trends zu folgenden Themen:

- 3D integration and interconnect technologies,
- Design of smart systems,
- Manufacturing of smart systems,
- System integration and packaging.

Highlights des Kongresses sind die Keynotes der Europäischen Kommission, des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich, von STMicroelectronics, Bosch Sensortec und AVL/IST. Zwei EPoSS-Sessions, eine Special Session zu Smart Systems Co-Design sowie eine Special Session zu Perspektiven von Smart Systems runden das Programm ab. Bei der begleitenden Fachausstellung präsentieren Forschungsinstitute, Komponenten- und Systemhersteller, Zulieferer und Dienstleister aus den Bereichen Mikro- und Nanotechnologie, Sensorik, kabellose Kommunikation sowie Mikroelektronik und -mechanik ihre Produkte und Lösungen. Aussteller treffen auf eine hoch spezialisierte internationale Zielgruppe aus Experten, Anwendern und Wissenschaftlern. Das komplette Kongressprogramm sowie weitere Informationen finden Sie unter:

www.smartsystemsintegration.com